JPU 1990-008070

Published on January 18, 1990

Title: A face lighting LED lamp

Inventor: Omiya ryoichi

Fuji Electric Co., Ltd., 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki,

Kanagawa, Japan

Applicant: Fuji Electric Co.,Ltd.

1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, Japan

Claims

 A face lighting LED lamp including an insulation case made of a synthetic resin, wherein a bottom surface of the insulation case is provided with plate-shaped electrodes on which a light emitting diode bare chip disposed on one plane in an insulation state is bonded and leading electrodes connected to an external circuit and an edge portion of the corresponding bottom surface is provided with a main wall and a reflecting surface reflecting light from the light emitting diode bare chip bonded to the plate-shaped electrode to the light emitting diode bare chip at the corresponding bottom surface and an inner side of the corresponding main wall, and the bottom surface of the insulating case is formed by filling all the insulation voids between the plate-shaped electrodes and the lead electrodes with a synthetic resin while exposing both surfaces of the plate-shaped electrode and the leading electrode.

## 公開実用平成 2—8070

⑨ 日本国特許庁(JP) ⑩実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(∪) 平2-8070

®Int. Cl. 5

H 01 L 33/00

N 7733-5 F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称

面照光LEDランプ

②実 願 昭63-83596

②出 額 昭63(1988)6月24日

@考 案 者 大 宮 良 一 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

创出 願 人 富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

四代理 人 弁理士 山口 嚴

### 明 細 書

- 1. 考案の名称 面照光LEDランプ
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- 3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この考案は、発光ダイオード(以下LEDと配



## 公開実用平成 2—8070

### (従来の技術)

この種の面照光しEDランプとして従来、第3図および第4図に示す構成のもの、すなわち第4図に示すように、表面にしEDベアチップ3がおンディングされる複数の板状電極1に等しいいと、外に色になって配され、これら底面7、板状電極1、引出

し電極4,5および間壁6が粉末状反射剤が混入された合成樹脂を用いて一体に注型成形され、底面7の上面側と同壁6の内面とでLEDベアチものプ3の発光を反射する反射面を形成する2とにのの反射面の内側に、LEDベアチョる金属細線8ととを保護する透明な樹脂9を充塡したものが知られている。

### (考案が解決しようとする課題)

入時の射出圧力によるリードフレーム101 背面側 すなわちリードフレーム101 を載置した金型側の 面とリードフレーム101 との間への樹脂のまわり 込みにより、リードフレーム101 を構成する複数 の板状電極1、引出し電極4、5のそれぞれの電 極相互間に段差が発生したり、底面7の上面側が ほぼリードフレーム101 で施われかつ注型樹脂の 成形硬化後の底面部の冷却に係わる板状電極1と 引出し電極4、5との間には面積差が存在してい ることから、底面7内に内部応力が発生したりす る可能性がある。内部応力が発生した場合、次工 程である、LEDベアチップ3と金属細線8とを 保護する樹脂19の充塡の際の加熱により内部応力 もしくは内部歪みが開放され、ボンディング部の 接合力が不足していると点灯不良という問題が発 生 し 、 し か も こ れ が 潜 在 し た 状 態 で 製 造 工 程 が 進 行して、製品の品質にばらつきが生じるおそれが ある。なお、上記従来構成の面照光ランプにおけ る問題点のうち、リードフレーム101 を構成する それぞれの電極相互間の段差の発生を防止する方

法として、実開昭57-177578号公報に開示されて いるように、底面7とリードフレーム101 と周壁 6 とを一体に注型するに先立ち、あらかじめリー ドフレームを板状電極1と引出し電極4. 5 とが 絶縁ケース100 の外側位置で一体化されたものと して形成し、このように形成されたリードフレー ムを金型で固定して底面?とこのリードフレーム と周壁 6 との一体注型成形後に絶縁ケース100 の 外側にあるリードフレーム101 の部分を、引出し 電極を残して切断、除去する方法も考えられる。 しかし、このような方法による段差の解消には、 複数の板状電極1と引出し電極4,5とが絶縁ケ ース外部の位置で一体化されたリードフレームを 形成する工程と、一体成形後に絶縁ケース外部に あるリードフレームの部分を、引出し電極4,5 を残して切断、除去する工程とを必要とし、製造 工程数が増すという問題を生ずる。

この考案の目的は、前記従来構成による面照光 LEDランプの問題点に鑑み、LEDベアチップ がボンディングされる板状電極と外部回路に接続

## **公開実用**平成 2—8070

される引出し電極とがそれぞれ互いに段差を生ずることなく、また、内部応力もしくは内部歪みが少なく、そして製造工程数を増すことなくLEDベアチップ発光の反射面が形成される面照光LEDランプの構成を提供することである。

(課題を解決するための手段)



#### 〔作用〕

絶縁ケースの底面をこのように形成すれば、板 状電極、引出し電極全ての両面が露出しているか ら、合成樹脂による一体成形時に板状電極,引出 し電極のすべてをたとえば上下に2つ割り構造と なる金型で挟んで両金型の間に固定し、この状態 で金型内に樹脂を圧入することができるから、板 状電極、引出し電極それぞれの間に段差を生ずる ことなく一体成形が可能となり、また、板状電極, 引出し電極のそれぞれ電極相互の一体化は電極相 互間の絶縁空隙を充満する合成樹脂を介して行わ れるから、一体注型成形後にこの充満された合成 樹脂内に発生しうる内部応力は板状電極、引出し 電極のそれぞれ面方向の応力であり、一体注型成 形後の次工程としてLEDベアチップと金属細線 とを保護する透明樹脂の充塡の際の加熱による前 記内部応力の開放時に電極面を反らせるような力 は発生しないから、一旦接合されたLEDベアチ ップが接合力不足による点灯不良という問題を生 ずるおそれもなくなる。しかも、上述のような段

差や点灯不良の問題の解消が従来の製造工程数を 増すことなく行われ、従って従来と同一コストで 品質の安定した製品を供給することが可能となる。 〔実施例〕

第1図および第2図に本考案の一実施例を示す。 LEDベアチップ3がボンディングされる板状電 極 13 は 、 ボ ン デ ィ ン グ 位 置 の 設 定 を 容 易 に す る た めとLEDベアチップ3の発光を効果的に反射す るためにボンディング位置を擂り鉢状にくぼませ てプレス成型され、そのフランジ部13a(第2図) と引出し電極4、5とが同一平面内にあるように、 図示されない2つ割り構造の金型により両面側か ら挟んで金型内に固定保持される。この状態で酸 化アルミニウム,炭酸カルシウムなどの粉末を反 射剤として混入した合成樹脂を圧入し、板状電極 13 お よ び 引 由 し 電 極 4 、 5 を 底 面 の 構 成 部 材 と し かつそれぞれの電極相互間の絶縁空隙に合成樹脂 を充満させつつ周壁16まで含めて一体成形して絶 緑ケース102 を形成する。しかる後、LEDベア チップ 3 を板状電極13の四部14にポンディングす

#### 〔考案の効果〕

以に、ないのでは、、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないでは

出させるとともに板状電極、引出し電極それぞれ の間の絶縁空隙全てに合成樹脂を充満させて形成 するようにしたので、板状電極、引出し電極全で を金型で固定保持した状態で絶縁ケースの注型成 形が可能となり、板状電極、引出し電極それぞれ の間の段差の発生が防止され、また、板状電極・ 引出し電極それぞれの電極相互の一体化が電極相 互間の絶縁空隙を充満する合成樹脂を介して行わ れるから、この充満された合成樹脂内に発生しう る内部応力は板状電極、引出し電極のそれぞれ面 方向の応力となり、絶縁ケースの注型成形後の次 工程としてLEDベアチップと、LEDベアチッ プを相互に接続する金属細線とを保護する透明樹 脂の充填の際の加熱による前記内部応力の開放時 に電極面を反らせるような力は発生しないから、 一旦接合されたLEDベアチップが接合不良によ り点灯不良を生ずるというような問題も生じなく なる。しかも上述のような段差や点灯不良の問題 解消を、従来の製造工程数を増すことなく行うこ とができるから、従来と同一コストで品質の安定 した製品を供給することができるという効果がある。なお、板状電極と引出し電極とからなるリードフレームの両面が樹脂で覆われていないために 熱放散が良くなり、温度上昇を抑制することが可能となる副次的効果も合わせて得られる。

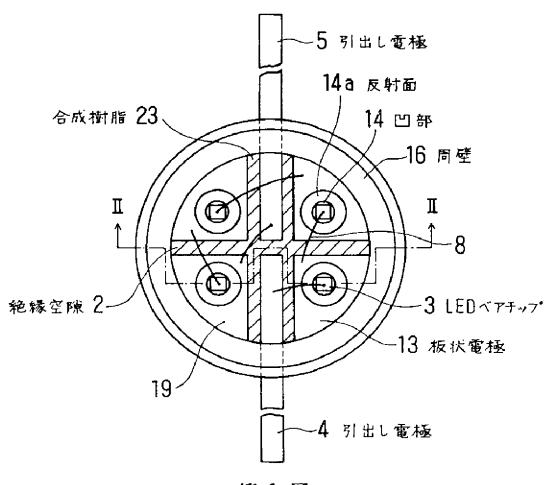
### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案による面照光しEDランプ構成の一実施例を示す平面図、第2図は第1図のⅡ~Ⅱ位置において矢印方向にみた側面断面図、第3図は従来の面照光ランプの構成例を示す平面図、第4図は第3図のⅣ~Ⅳ位置において矢印方向にみた側面断面図である。

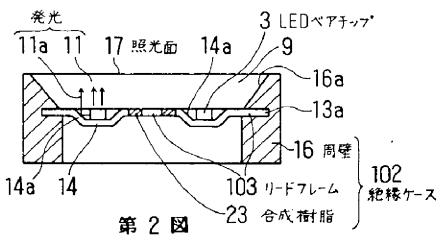
1,13:板状電極、2: 絶縁空隙、3:LEDベアチップ、4,5:引出し電極、6,16:周壁、10,17:照光面、11,11a:発光、14a,16a:反射面、23:合成樹脂、100,102: 絶縁ケース、101,103:リードフレーム。

代理人并理士 山 口 展





第1図

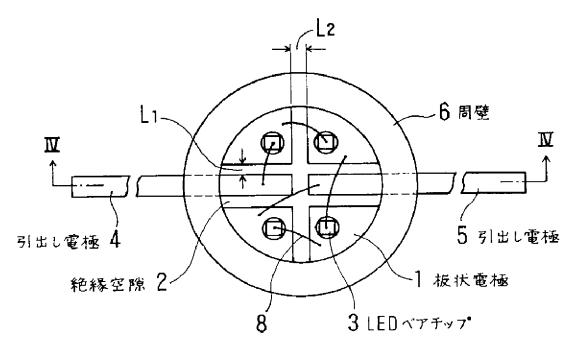


代理人并理士 山 口 藏

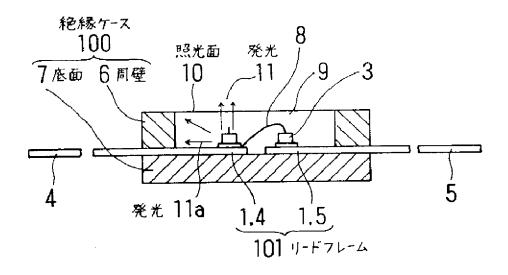
798

実開2-8070





第3図



第 4 図

